

六、美中衝突後，台灣對外直接投資及貿易結構改變之分析

2018 年美中衝突後，全球供應鏈進一步重組，**台商**從早期的成本及效率導向，轉向**多元化布局**、提高供應鏈韌性，**經貿布局除擴大在台投資，海外直接投資重心亦**從「西進」(中國大陸)**轉向「新南向」與「東進」**(美國)；近年美國加大關鍵物資供應鏈在地化政策力道，**2023、2024 年美國成為台灣最大對外直接投資地**。

台灣持續深耕高科技與資訊安全領域，半導體及伺服器供應鏈完整且具競爭優勢，推動**台灣成為全球 AI 硬體製造核心**。生成式 AI 熱潮下，**美國 AI 基礎建設持續增加，帶動其對台灣電子及資通產品需求，2025 年成為台灣最大的出口及出超國**。同時，全球供應鏈的重組過程中，東協扮演「中國+1」的要角，台商部分生產基地由中國大陸轉進東協，帶動台灣**對東協貿易出超亦擴增**。此外，由於**AI 供應鏈國際分工密切且台灣對記憶體等電子零組件需求強勁，南韓及日本為台灣前兩大入超國**。

本文擬以問答方式，分析美中衝突後，台灣對外直接投資及貿易結構之影響，俾供外界參考。

Q1：2018 年美中衝突後，全球供應鏈加速重組，對台灣對外直接投資的影響為何？

Q2：隨對外直接投資結構改變，台灣外銷訂單的生產地區有何變化？

Q3：台灣對外直接投資布局的變化，是否帶動台灣外貿結構的改變？

Q4：美中衝突及 AI 熱潮，台灣及主要國家對全球及美國貿易出入超的變化為何？

Q5：美中衝突以來，台灣在全球供應鏈的角色有何轉變？

Q1：2018 年美中衝突後，全球供應鏈加速重組，對台灣對外直接投資的影響為何？

A1：台灣對外直接投資地區多元化，經貿布局從「西進」轉向「新南向」與「東進」。

(一)1990 年後，台商因成本及效率考量，積極西進中國大陸投資。

— 早期**中國大陸具勞動及土地成本低廉等優勢**，且**加入 WTO 後**，引進大量外資，成為世界工廠，**台商亦大舉西進投資**，截至**2017 年底**，**台灣對中國大陸直接投資比重高達 58.3%**(圖 1)。

(二)美中衝突以來，隨全球供應鏈重組及因應先進國家強化半導體等關鍵物資生產在地化，台灣對中國大陸投資比重明顯減少，對美國及東協等投資比重則增加。

1. 降低對中國大陸直接投資比重：隨中國大陸生產成本上升、「中國+1」策略及**全球供應鏈重組**，**台灣對中國大陸直接投資的比重大幅**降至 2018 至 2025 年的 18.8%。

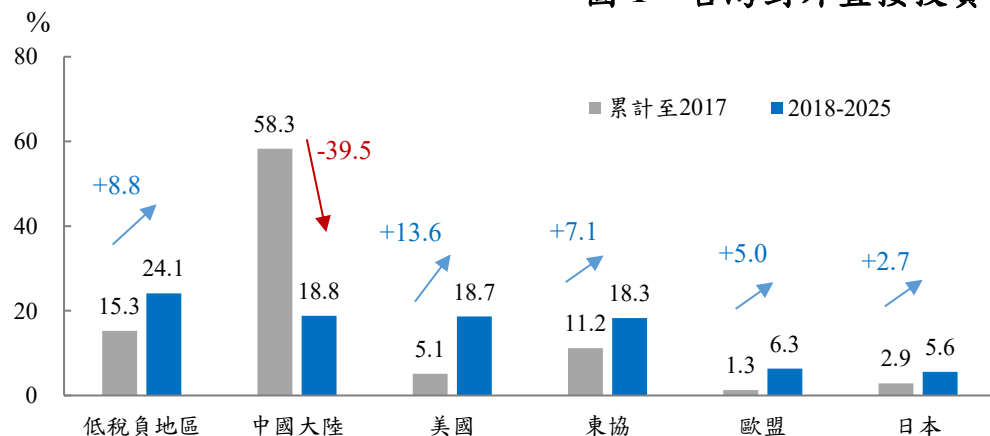
2. 增加對美國、東協、歐盟及日本直接投資比重，擴大海外多元布局。

— 隨**川普 2.0 推動美國在地生產**，**台灣資訊電子工業¹擴大在美生產**，**對美直接投資比重上升至 18.7%**；其中，2023 及 2024 年對美國直接投資比重達 36.4%及 29.1%，為台灣最大的對外直接投資地。

— 為增加供應鏈韌性，分散生產基地，台灣**對東協投資比重**由 2017 年以前的 11.2%，**上升至 18.7%**。

— 歐、日等先進國家亦強化半導體等關鍵物資生產在地化，2018 年以來台灣**對歐盟及日本直接投資比重**分別**上升至 6.3%及 5.6%**。

圖 1 台灣對外直接投資比重(地區別)



註：1.台灣對中國大陸的直接投資含直接及間接管道(即透過第三地間接投資中國大陸)，且為核准數。

2.低稅負地區包括英屬維京群島、英屬開曼群島、百慕達、巴拿馬、薩摩亞。

3.近年台灣對低稅負地區投資增加，主要係台積電增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD.，從事經營一般投資業務，降低外匯避險成本。

資料來源：經濟部投審司

¹ 包括電子零組件製造業與電腦、電子產品及光學製品製造業。

Q2：隨對外直接投資結構改變，台灣外銷訂單的生產地區有何變化？

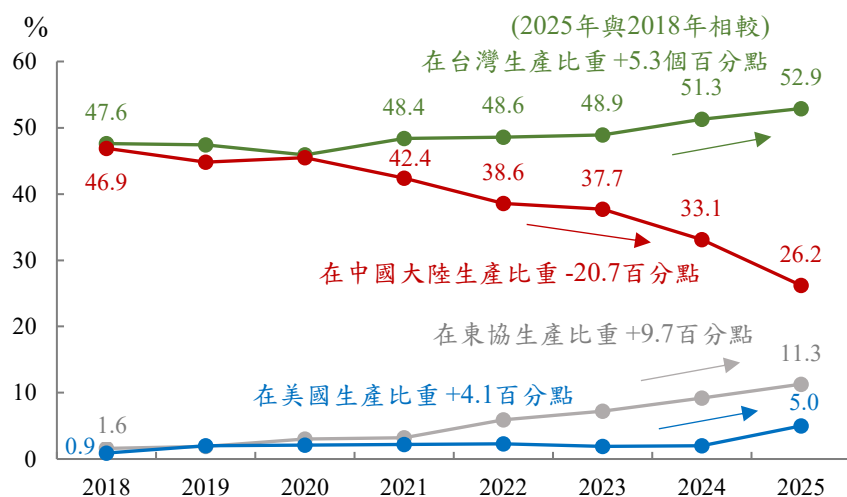
A2：台灣外銷訂單在國內生產比重上升，助益台灣出口量能；在中國大陸生產比重續降，其中「台灣接单、中國大陸生產、銷售美國」的三角貿易式微，改由台灣或經東協等地再外銷。

(一)美中衝突下，涉及資安等高科技及高階產品移回台灣生產；2018 年起，台灣外銷訂單在台灣生產比重超越在中國大陸生產比重，2025 年該比重創 52.9%新高，有利台灣出口成長。

(二)台灣外銷訂單在中國大陸生產比重下降，部分改由台灣或經東協等地出口美國，甚或移往美國在地生產。

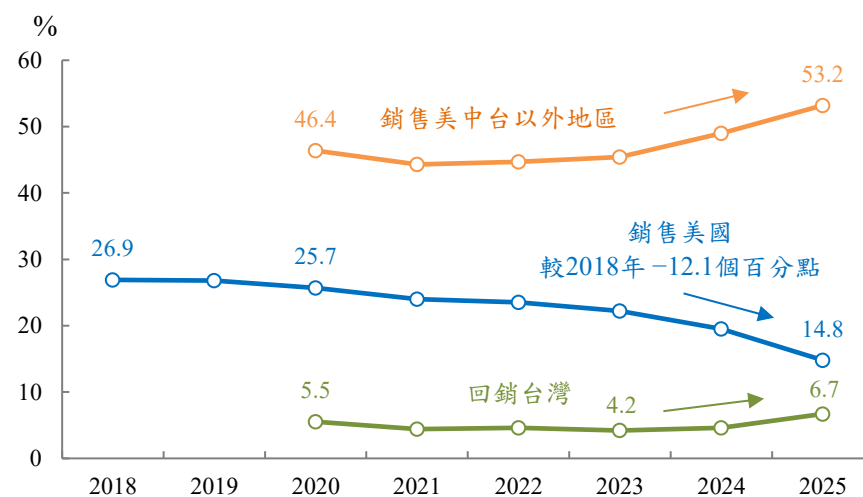
1. 台商調整海外各地投資及產能配置，2025 年台灣外銷訂單在中國大陸生產比重續降至 26.2%；在東協及美國生產比重分別上升至 11.3%及 5.0%(圖 2)。
2. 美中對立下，台灣外銷訂單在中國大陸生產的貨品中，銷售結構明顯改變：
 - 2025 年銷售美國的比重降至 14.8%，反映「台灣接单、中國大陸生產、銷售美國」的三角貿易式微。
 - 銷售美中台以外地區的比重上升至 53.2%，可能係部分中國大陸生產貨品繞道東協等地加工，再出口美國(圖 3)。

圖 2 台灣外銷訂單在各地生產比重



資料來源：經濟部統計處

圖 3 台灣外銷訂單在中國大陸生產貨品之銷售地區比重



註：回銷台灣及銷售美中台以外地區資料始於 2020 年。

資料來源：經濟部統計處

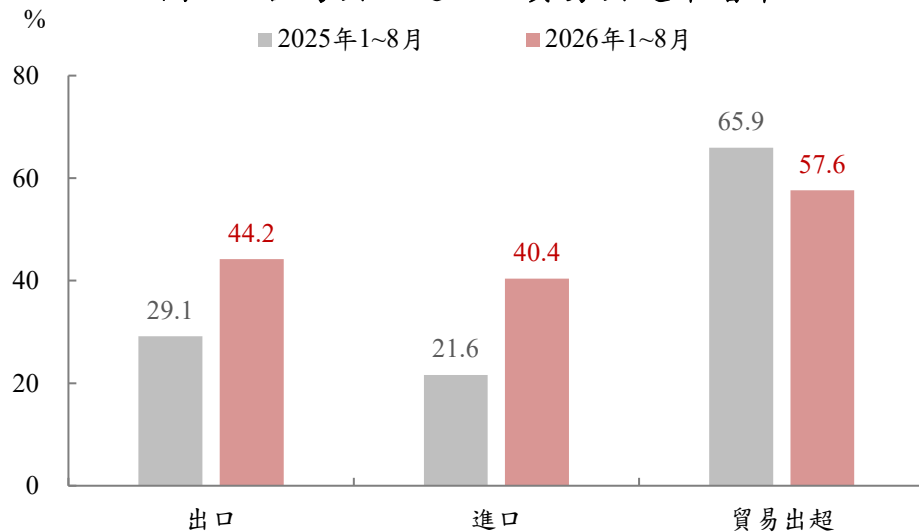
Q3：台灣對外直接投資布局的變化，是否帶動台灣外貿結構的改變？

A3：台灣對外直接投資多元布局，及外銷訂單生產基地移回台灣及東協生產再銷往美國，牽動台灣商品貿易結構的改變，對美國、東協出超擴大，對南韓及日本則呈貿易入超。

(一)受惠 AI 等新興科技應用發展，台灣出、進口金額及貿易出超均創歷年同期新高。

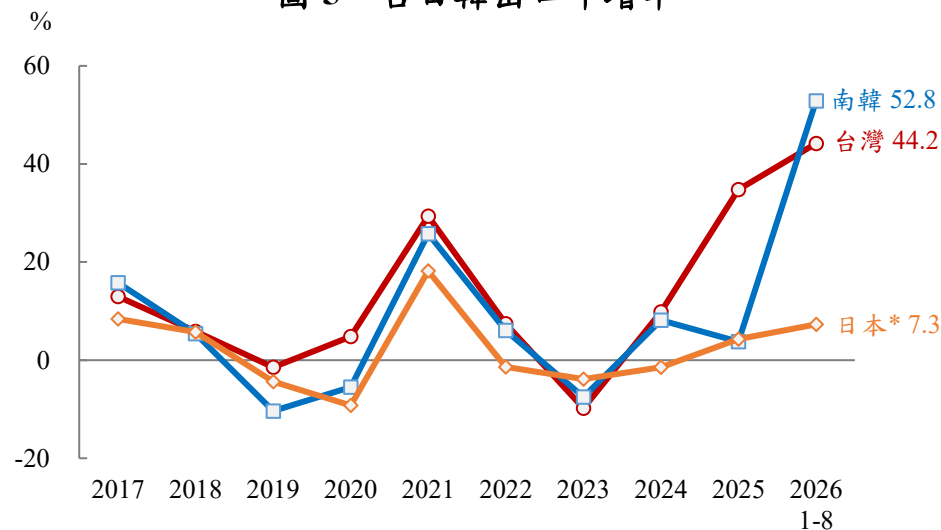
1. 本年 1 至 8 月台灣**出口**較上年同期增加 **44.2%**，主要係 **AI 需求持續擴增**，且**相關產品報價調漲**；隨 **AI 產業鏈國際分工與出口引申需求增加**，加以**國際原物料價格攀升**，**進口**較上年同期增加 **40.4%**(圖 4)。同期間，**商品貿易出超**大幅**增加 57.6%**，**達 1,369.1 億美元，創歷年同期新高**。
2. 本年以來，**高頻寬記憶體(HBM)供不應求**、報價大幅上漲，**南韓在高階記憶體具領先優勢，推升南韓出口表現略優於台灣**，年增率 **52.8%**²；**日本出口結構相對分散**，受惠 AI 熱潮程度低於台、韓，**出口成長較為平緩**，年增率 **7.3%**(圖 5)。

圖 4 台灣出、進口及貿易出超年增率



資料來源：台灣財政部

圖 5 台日韓出口年增率



註：日本尚未公布 8 月貿易數據，其資料採 1~7 月數值。

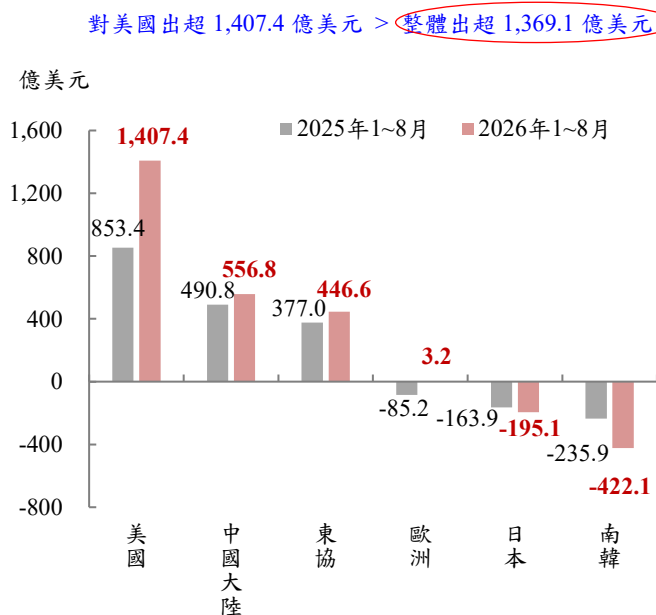
資料來源：台灣財政部、日本及南韓通關統計

² 本年 1 至 8 月南韓出口年增 52.8%，其中，若依出口價量分析，其最新公布之 1 至 7 月出口物價增幅(27.7%)大於出口數量增幅(17.8%)，且積體電路(主要為記憶體)之出口物價成長 143.9%。

(二)台灣對美國及東協出超擴增，反映台商近年陸續將高階產品移回台灣生產，且中低階產品移往東協生產之全球布局策略。

1. 本年1至8月台灣商品貿易出超**1,369.1億美元**，較上年同期增加**500.5億美元**。
2. 美國為台灣最大貿易出超國(圖6)，主要為高階資通與視聽產品(圖7)，其中，顯示卡及伺服器出超比重近9成。
— 本年1至8月台灣對美國出超**1,407.4億美元**(大於對全球出超)，增額**554.0億美元**(大於對全球出超增額)。
3. 東協具勞動力及土地成本優勢，為台商「中國+1」策略之中低階資通訊產品的替代加工與製造基地。
— 在AI商機挹注下，帶動東協增加自台灣進口電子零組件及資通與視聽產品(圖8)。
— 本年1至8月台灣對東協貿易出超達**446.6億美元**，為歷年同期新高。

圖6 台灣對主要地區商品貿易出入超
(2026年1~8月)



資料來源：台灣財政部

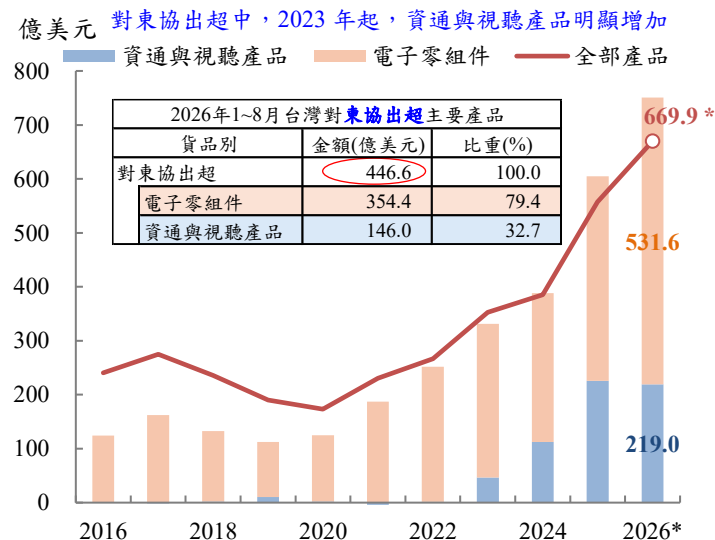
圖7 台灣對美國商品貿易出超



註：1. * 2026 年全年金額係該年 1~8 月均值×12 估算。
2. 資通與視聽產品主要為顯示卡(用於 GPU 等較高階產品)、伺服器與電腦零組件。

資料來源：台灣財政部、經濟部國貿署

圖8 台灣對東協商品貿易出超



註：* 2026 年全年金額係該年 1~8 月均值×12 估算。
資料來源：台灣財政部、經濟部國貿署

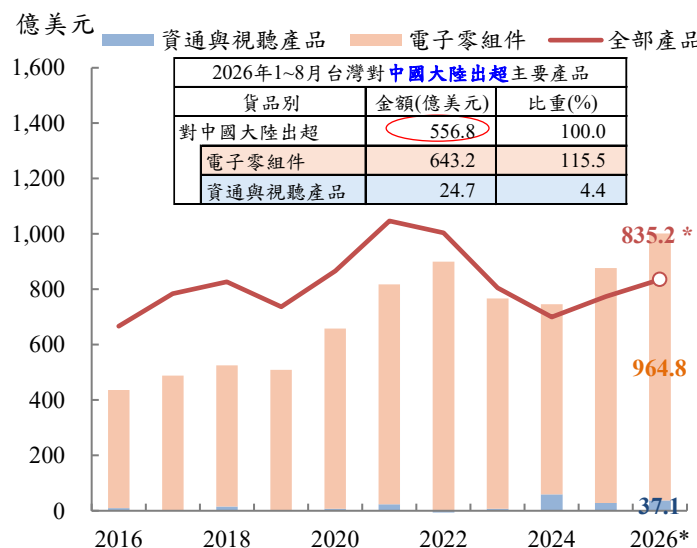
4. **中國大陸**為台灣第2大貿易出超國，且高度集中於**積體電路**，其出超達655.8億美元。
- 隨**中國大陸**推動在地化生產，並**積極發展AI**，加以台廠在兩岸電子零組件**供應鏈上下游貿易往來密切**，本年1至8月**中國大陸穩居台灣最大進口來源**，且**台灣對其出口增加28.3%**，貿易出超**556.8億美元**(圖9)。

(三)由於AI供應鏈及台灣對記憶體需求強勁，南韓及日本為台灣前兩大入超國。

1. 2024年起，南韓為台灣**最大貿易入超國**，本年1至8月台灣對**南韓貿易入超**增至**422.1億美元**(圖10)。
- AI產業鏈國際分工密切，**記憶體**為台灣對南韓最大**入超產品**(比重**95.5%**)。
2. **日本**為台灣**第2大貿易入超國**，本年1至8月台灣對日本入超增至195.1億美元(圖11)。
- 自日本入超主要係**精密機械**、**化學材料**、**記憶體**等半導體生產相關產品。

圖9 台灣對中國大陸商品貿易出超

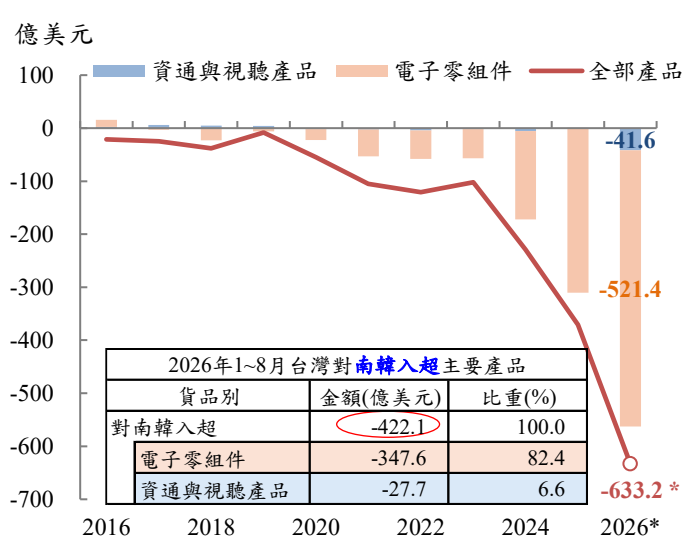
對中國大陸電子零組件(主要為積體電路)出超，大於全部產品出超



註：1.* 2026 年全年金額係該年 1~8 月均值×12 估算。
2. 對中國大陸電子零組件出超，主要係積體電路出超。
資料來源：台灣財政部、經濟部國貿署

圖10 台灣對南韓商品貿易入超

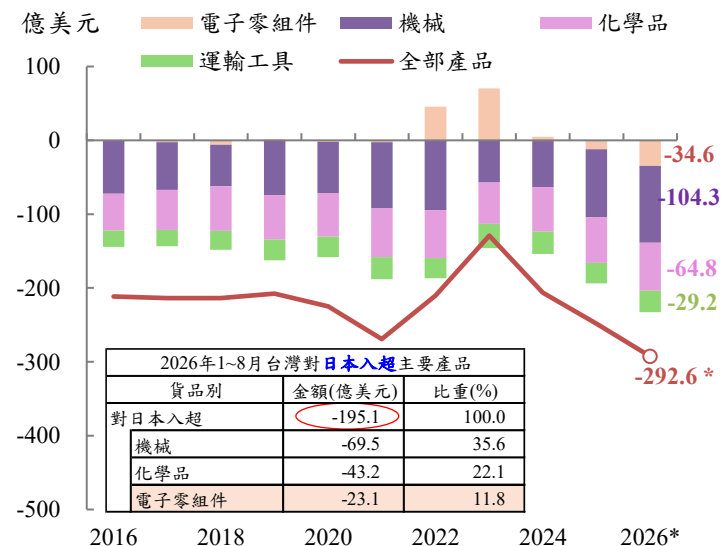
對南韓入超，主要來自電子零組件(主要為記憶體)



註：1.* 2026 年全年金額係該年 1~8 月均值×12 估算。
2. 對南韓電子零組件入超，主要係記憶體入超。
資料來源：台灣財政部、經濟部國貿署

圖11 台灣對日本商品貿易入超

對日本入超的產品多元，主要係與半導體生產相關



註：1.* 2026 年全年金額係該年 1~8 月均值×12 估算。
2. 對日本電子零組件入超，主要係記憶體入超。
資料來源：台灣財政部、經濟部國貿署

Q4：美中衝突及 AI 熱潮，台灣及主要國家對全球及美國貿易出入超的變化為何？

A4：美國積極投入 AI 基礎建設，對資通與視聽產品進口需求持續增加，入超擴大；本年 1 至 7 月台灣成為美國第 3 大貿易入超國，僅次於越南及墨西哥。

(一) 預估美國 2026 年對全球入超逾 1 兆美元，續為全球最大貿易入超國，亞洲主要經濟體則為主要出超國。

— **美國**強化資安防護及**擴大 AI 基礎建設**，資通與視聽產品**進口需求大增**，**續為全球最大貿易入超國**。

— 受惠 AI 等新興科技應用需求熱絡，中國大陸、南韓、台灣、新加坡及馬來西亞等亞洲國家貿易出超擴增。

台灣 ICT 產品具國際競爭力，預估 **2026 年**台灣對全球貿易**出超**可望**逾 2,000 億美元**，為 2018 年的 4.2 倍(表 1)。

(二)2018 年起，美國對中國大陸貿易入超明顯減少，取而代之者主要為越南、墨西哥及台灣。

— 美中衝突下，**預估本年**美國對中國大陸貿易入超 1,564 億美元，較 2018 年減少 2,619 億美元；本年 1 至 7 月**台灣**為美國**第 3 大**貿易入超國，預估全年美國對台灣**入超金額逾 2,000 億美元**(表 2)。

(三)近年台灣增加對美直接投資，部分原由台灣出口至美國之產品可望轉為當地供應，有助縮小對美國貿易出超。

表 1 主要經濟體商品貿易出入超

單位：億美元；倍數

	2026 年* A	2018 年 B	增減額 C=A-B	倍數 D=A/B
中國大陸	12,083	3,509	8,573	3.4
南韓	3,038	697	2,341	4.4
台灣	2,054	492	1,561	4.2
新加坡	987	413	574	2.4
馬來西亞	732	307	425	2.4
印尼	63	-87	150	—
日本	-179	-103	-76	1.7
越南	-348	72	-420	—
菲律賓	-606	48	-654	—
泰國	-640	-435	-205	1.5
美國	-11,015	-8,704	-2,312	1.3

表 2 美國前 10 大貿易入超國

貿易對象	2026 年*		2018 年		增額
	金額 (億美元) A	美國 入超 排名	金額 (億美元) B	美國 入超 排名	金額 (億美元) C=A-B
全球	11,015		8,704		2,312
越南	2,380	1	395	6	1,986
墨西哥	2,210	2	777	2	1,432
台灣	2,192	3	152	15	2,039
中國大陸	1,564	4	4,182	1	-2,619
泰國	1,137	5	193	10	944
南韓	793	6	179	13	613
德國	633	7	680	3	-47
印度	488	8	211	9	277
加拿大	483	9	188	12	295
馬來西亞	461	10	264	8	197

註：1. 出超及入超分別以正數及負數表示。

2. *中國大陸、南韓及台灣 2026 年全年金額係該年 1~8 月均值×12 估算，其餘國家因僅公布至 7 月，採 1~7 月均值×12 估算。國別按 2026 年貿易餘額金額排序。

資料來源：美國商務部、LSEG Datastream、CEIC

註：1. 為利於入超增減的比較，本表以正數表達入超金額。

2. *2026 年全年金額係該年 1~7 月均值×12 估算。

前 10 大係按 2026 年入超金額排序。

資料來源：美國商務部

Q5：美中衝突以來，台灣在全球供應鏈的角色有何轉變？

A5：美中衝突、全球供應鏈重組，台灣適時調整全球投資布局，成為全球 AI 硬體製造核心，對美出超倍增。

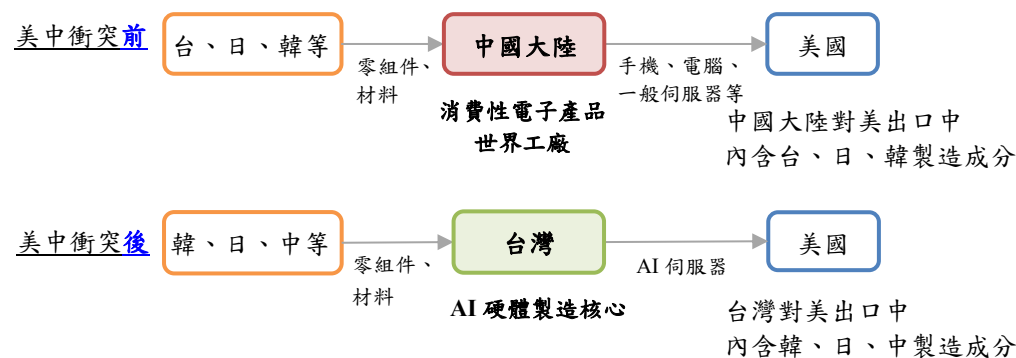
(一)全球強化供應鏈韌性、重視資安及規避關稅，減少對中國大陸直接投資，打破過往「中國大陸集中製造」的模式。

(二)2018 年美中衝突後，台商因應「中國+1」布局，擴大在台生產，並朝「新南向」及「東進」布局，進而改變台灣出口結構；且隨 AI 熱潮，提高台灣 AI 製造的優勢及出口量能。

1. 台灣電子資訊產業具完整生產聚落，美中衝突後，台商高階產品移回台灣生產，加以 AI 熱潮，推動台灣成為全球 AI 硬體製造核心，致使對美出口及出超鉅增(圖 12)。
2. 台商部分生產基地由中國大陸轉進東協，帶動台灣對東協電子資訊產品出口金額躍升，亦有利台商彈性調配各地產能，提高 AI 供應鏈韌性。

圖 12 美中衝突前後台灣在全球供應鏈角色的轉變

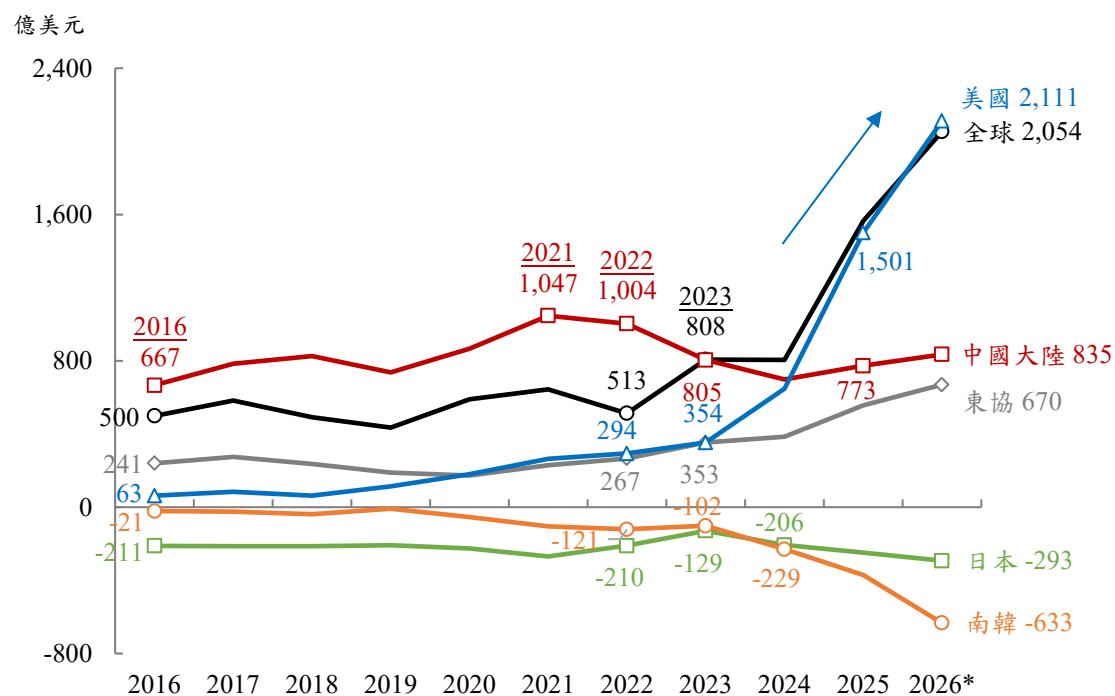
	美中衝突前	美中衝突後
在全球生產的角色	中國大陸是消費性電子產品的世界工廠	台灣成為 AI 製造的核心
對美國出口中，內含他國製造的成分	中國大陸對美國的出口中，內含其自台灣、日本、南韓等的進口；這些國家製造的零組件及材料，經由中國大陸加工組裝為成品，銷售至美國，計入中國大陸對美國的出口	台灣對美國的出口(如 AI 伺服器)中，除台灣製造的成分(如晶圓製造、先進封裝、系統整合)，亦含有台灣自南韓(如記憶體)、日本(如化學材料)及中國大陸(如電子零組件)等的進口，計入台灣對美國的出口
推升對美國的出超	推升中國大陸對美國的出超	推升台灣對美國的出超



註：1.本圖為簡單示意圖，實際上各國彼此間皆為雙向貿易。
2.台灣對美國出口增加，亦帶動自歐盟光刻機等高端設備進口增加，以及與東協等相關國家進出口增加。
3.台灣與中國大陸及東協間之貿易往來對象，有相當部分為台廠。

3. 美中衝突後，台灣成為全球 AI 硬體製造核心，對美出口增加，亦帶動台灣自南韓及日本進口大量記憶體等電子零組件，致台灣對南韓、日本入超亦擴大(圖 13)。

圖 13 台灣對主要國家貿易出入超



註：* 2026 年全年金額係該年 1~8 月均值×12 估算。

資料來源：台灣財政部、經濟部國貿署